

杭州中威电子股份有限公司

关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，主要用于包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等，授信期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：

1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，最终融资金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准；

2、上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行等金融机构协商确定。

3、公司视经营需要在授信额度内进行融资（在过渡期内，每一笔融资均需经管理小组同意后方可进行），事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。

4、公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内审核并签署相关法律文件。

本次授信事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2021年4月27日